

お問合せ先
OBARA GROUP株式会社
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間3-2-10
TEL. 046-271-2122

適切に管理された森林からの原料を含むFSC®認証紙之環境に配慮した植物油インキを使用
していただきます。



www.obara-g.com

OBARA-G REPORT

第61期 第2四半期報告書

2018年10月1日………2019年3月31日

証券コード 6877

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。OBARA GROUPの2019年第2四半期連結累計期間における事業の概況等をご報告致します。

世界経済は、通商問題の動向や新興国経済の先行き不透明感が懸念されたものの、米国や欧州地域における回復基調の持続から、全体として緩やかな成長で推移しました。

我が国経済につきましては、工業生産が概ね横ばいの推移となる中で、設備投資の増加や個人消費の持ち直しが見られるなど、緩やかな景気回復が続きました。

そのような外部環境の下、溶接機器関連事業は自動車メーカーの生産活動や設備投資への対応を継続的に展開し、平面研磨装置関連事業は堅調な設備投資が行われたエレクトロニクス関連素材への拡販活動に努めました。この結果、親会社株主に帰属する四半期純利益が、前期に計上した特別利益の一巡などにより前年同期を下回ったものの、売上高及び営業利益では、前年同期を上回る結果となりました。

なお、当社は株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策として認識しており、2019年度の第2四半期末配当金につきましては、1株につき40円とし、本年6月10日を支払開始日とさせていただきます。



今後も不透明な経済環境が予想されますが、当社と致しましては、引き続き成長市場への経営資源の投入を積極的に推進し、顧客ニーズを満たす製品及びサービスの提供を行うことにより、業績向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、OBARA GROUPへの倍旧のご支援を心よりお願い申し上げます。

2019年6月

取締役社長 小原 康嗣

目次	株主の皆様へ ▶01	セグメント別事業概況 ▶05	主要経営指標の推移 ▶11	会社情報 ▶16	株主メモ ▶18
	営業の概況 ▶03	トピックス ▶09	連結財務データ ▶13	株式情報 ▶17	

営業の概況

連結業績サマリー

(百万円)

	第2四半期累計期間			通期		
	前期	当期	前年同期比	前期	当期(予想)	前期比
売上高	24,645	27,606	12.0%	51,148	53,000	3.6%
営業利益	4,497	5,496	22.2%	9,319	9,500	1.9%
経常利益	4,579	5,816	27.0%	9,985	9,900	△0.9%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	4,309	4,048	△6.1%	8,200	7,000	△14.6%
1株当たり配当金	40円	40円	—	110円(年間)	90円(年間)	△20円

(注) 前期の期末配当金(確定)／1株当たり配当金70円
 当期の期末配当金(予想)／1株当たり配当金50円

03

第2四半期累計期間の概況について

当社グループと深く関わる自動車業界では、新興国などで新モデル投入などによる堅調な設備投資が行われる中、生産活動は総じて弱含む流れを示しました。一方、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、先端デバイス向け設備投資が慎重化したものの、エレクトロニクス関連素材では堅調な設備投資が継続しました。当社グループは、このような経営環境において各市場動向に応じた拡販に努めたことなどにより、親会社株主に帰属する四半期純利益が、前期計上の特別利益の一巡などにより減益となったものの、売上高及び営業利益では前年同期を上回る結果となりました。

通期の見通しについて

当社グループと深く関わる自動車業界では、通商問題からの間接的な影響が懸念されるものの、堅調な設備投資が行われています。また、同じく当社グループと深く関わるエレクトロニクス業界では、エレクトロニクス関連素材における底堅い設備需要が見込まれています。そのような環境下、当社グループの通期業績につきましては、期初計画の水準を予想しておりますが、当社グループとしましては、成長市場での販売促進を鋭意図るとともに、継続的に設備投資と研究開発を行ってまいります。

なお、当連結業績予想は、1米ドル=110円の為替レートを前提としています。

04

セグメント別事業概況

溶接機器
関連事業

事業紹介

溶接機器関連事業とは

自動車業界を主要マーケットとする高効率な抵抗溶接機器を製造・販売しています。

自動車が出来るまで

● 溶接機器関連事業と関わる自動車の製造プロセス

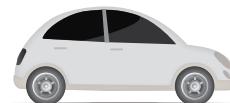
車体溶接

塗装

ぎ装

完成

出荷



車体溶接の設備

OBARA GROUP が提供する溶接機器

自動車ボディは薄板鋼板で構成されるため、抵抗溶接という接合工法が採用されています。

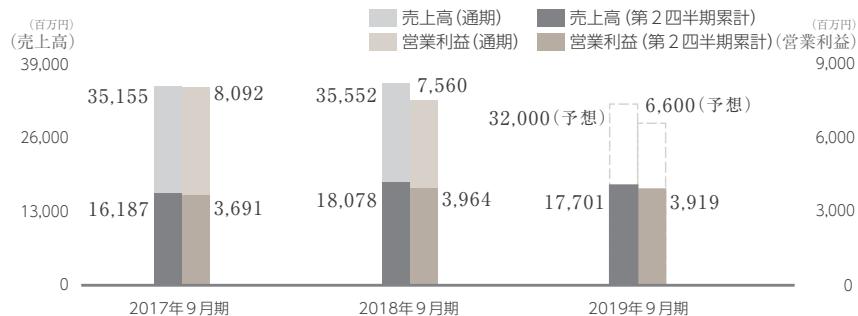
抵抗溶接は、接合ポイントに適切な加圧力と溶接電流を与える必要があります。自動車ボディの組立てには、各自動車モデル固有の立体形状に合わせ、個々の接合ポイントにカスタマイズされた溶接機器が設計・製造されます。

私たちは、国内外の自動車メーカーが行う設備増強やモデルチェンジに伴う設備更新に対し、半世紀に亘って培った経験と最先端の設計・生産技術により、最適な抵抗溶接設備を提案します。日々の生産活動に不可欠な消耗品と合わせ、自動車業界のパフォーマンス要望に応えます。

溶接機器関連事業



溶接ガン



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

溶接機器関連事業につきましては、取引先である日系・アジア系自動車メーカーにおいて、アジア地域などで堅調な設備投資が行われたものの、世界各地で自動車生産が総じて弱含む流れを示しました。このような環境の下、アジア地域の業績は好調に推移したものの、当事業の業績は前年同期を下回りました。

この結果、当事業の売上高は177億1百万円(前年同期比2.1%減)、同営業利益は39億19百万円(前年同期比1.1%減)となりました。

売上高構成比

17,701

百万円……2019年9月期
第2四半期累計売上高

平面研削装置関連事業

溶接機器
関連事業

64.1%

セグメント別事業概況

平面研磨装置
関連事業

事業紹介

平面研磨装置関連事業とは

エレクトロニクス業界を主要マーケットとする精密研磨装置を製造・販売しています。

エレクトロニクス製品が出来るまで

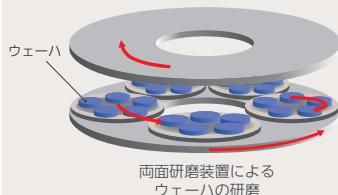
●平面研磨装置関連事業と関わるエレクトロニクス製品の製造プロセス

ウェーハ製造工程
インゴット引き上げ、切断、
ウェーハ研磨

半導体デバイス前工程
成膜、リソグラフィ、
エッチング等

半導体デバイス後工程
ダイシング、ボンディング、
モールドイング等

エレクトロニクス製品組込
完成した半導体デバイス(チップ)の
エレクトロニクス製品への搭載



OBARA GROUP が提供する平面研磨装置

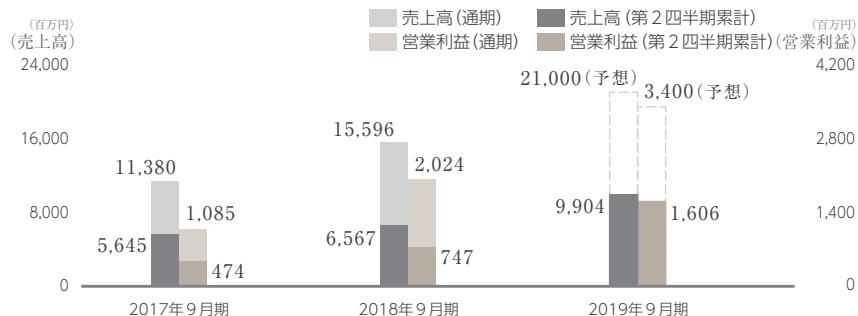
精密加工により製造される先端エレクトロニクス製品は、材料段階で高い面精度を基準平面として要求します。ロジックチップ・メモリーなどの半導体デバイスに用いられるシリコンウェーハ、通信・光デバイス基板、ハードディスク基板など、多様なエレクトロニクス素材の面精度の形成に、ダメージのない微細加工が可能な、遊離砥粒研磨装置が活躍しています。

現代社会を支える各種エレクトロニクス素材の期待水準に、私たちは、ナノオーダー対応の遊離砥粒研磨装置を中心とした精密装置ラインナップで応えます。また、信頼性の高い量産プロセスの確立に必要な、スラリー・研磨パッドなどの消耗副資材も開発・販売しています。

平面研磨装置関連事業



両面研磨装置



(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

売上高構成比



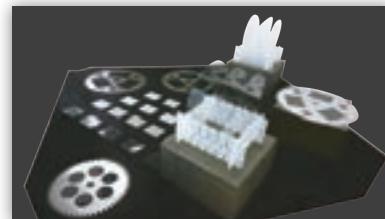
平面研磨装置関連事業につきましては、フラッシュメモリーを中心とした先端製品の需給調整が見られたものの、取引先であるエレクトロニクス関連素材において、堅調な生産活動や設備投資が続きました。このような環境の下、当事業として設備品及び消耗品の拡販を図ったことなどにより、業績は好調に推移しました。

この結果、当事業の売上高は99億4千万円(前年同期比50.8%増)、同営業利益は16億6百万円(前年同期比114.7%増)となりました。

トピックス

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Japanに出展

スマートフォンなどのエレクトロニクス製品には、最先端の半導体デバイスが搭載され、そのデバイスが形成されるシリコンウェーハの高精度化が進んでいます。2018年12月、東京ビッグサイトで開催された半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan」にて、当社グループは、次世代300mmウェーハに適應した装置・消耗副資材の総合ソリューションを提案したほか、SiCやGaNなどの新素材や、高周波・極薄水晶ウェーハに対応した最新の研磨装置ラインナップを紹介し、国内外から注目を集めました。



SEMICON Japan 2018

平面研磨装置関連事業／ SEMICON Chinaに出展

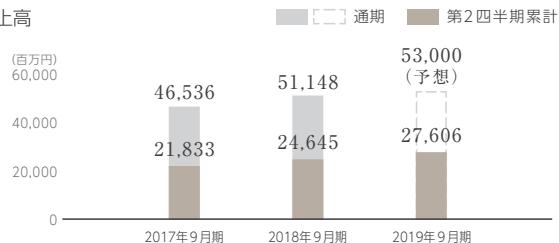
当社グループは、2019年3月、上海(中国)で開催されたエレクトロニクス関連技術の総合展示会「SEMICON China」に出展し、エレクトロニクス素材向けに最新の研磨プロセス技術を提案しました。シリコンウェーハ向け装置のほか、化合物半導体ウェーハや各種基板向けアプリケーションに対応した製品ラインナップを紹介し、多くの問い合わせを頂戴しました。当社グループは、ローカルニーズにも細かく対応し、顧客要望を具現化する高付加価値製品の開発に注力してまいります。



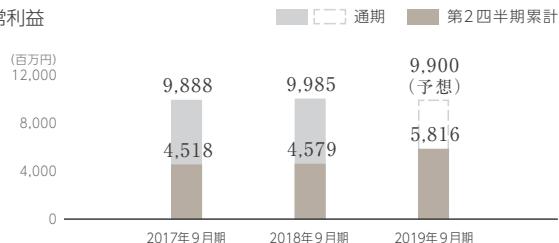
SEMICON China 2019

主要経営指標の推移

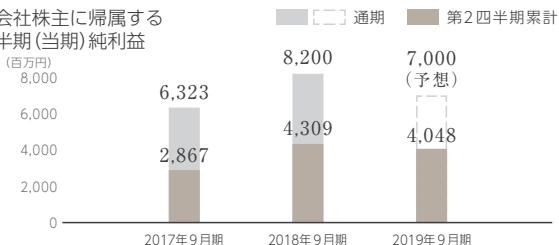
売上高



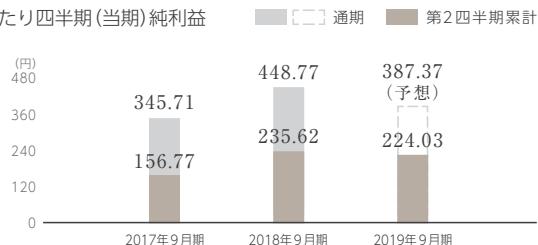
経常利益



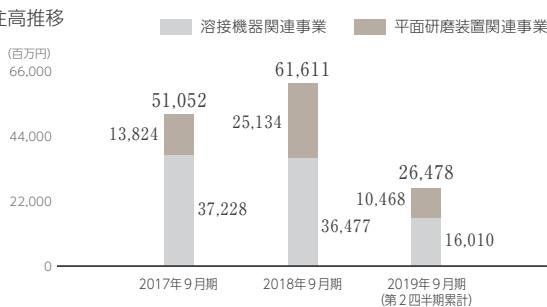
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



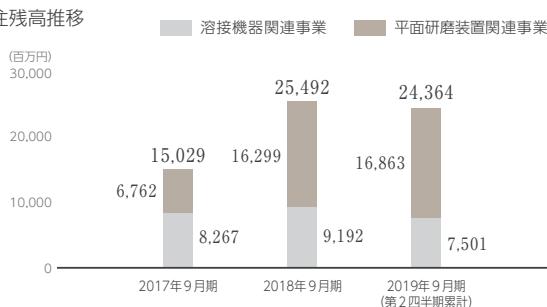
1株当たり四半期(当期)純利益



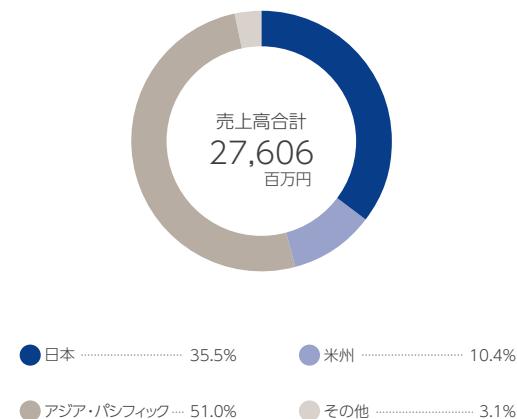
受注高推移



受注残高推移



地域別売上高構成比

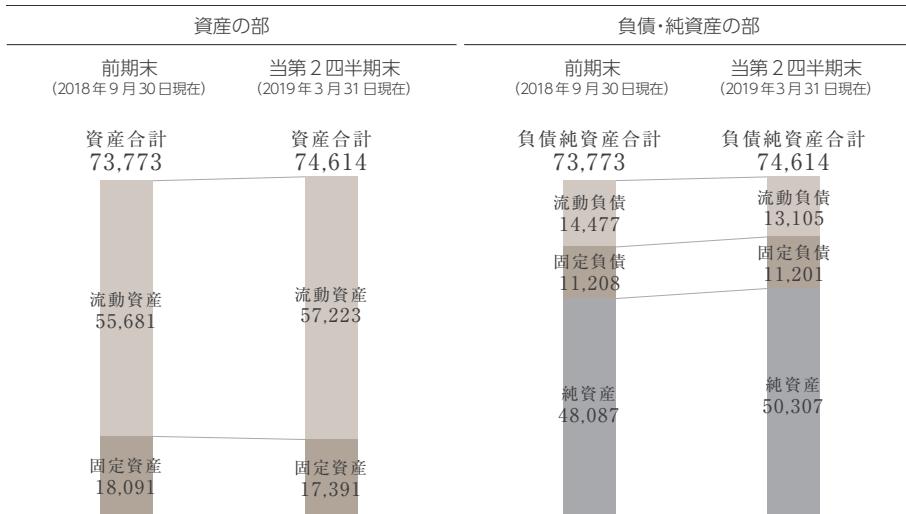


(注) 売上高については、外部顧客に対する売上高を記載しております。

連結財務データ

資産・負債・純資産の状況

(単位：百万円)



(注) 「[税効果会計に係る会計基準]の一部改正(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2018年9月期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

資産負債

point
1

総資産は746億14百万円と、前期末に比べて8億41百万円増加しました。有価証券が5億28百万円、商品及び製品が4億46百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が18億25百万円、仕掛品が7億47百万円増加したことなどによります。負債は243億7百万円と、前期末に比べて13億78百万円減少しました。短期借入金が3億52百万円、未払法人税等が3億69百万円、前受金が2億33百万円、賞与引当金が3億81百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が2億92百万円増加したことなどによります。

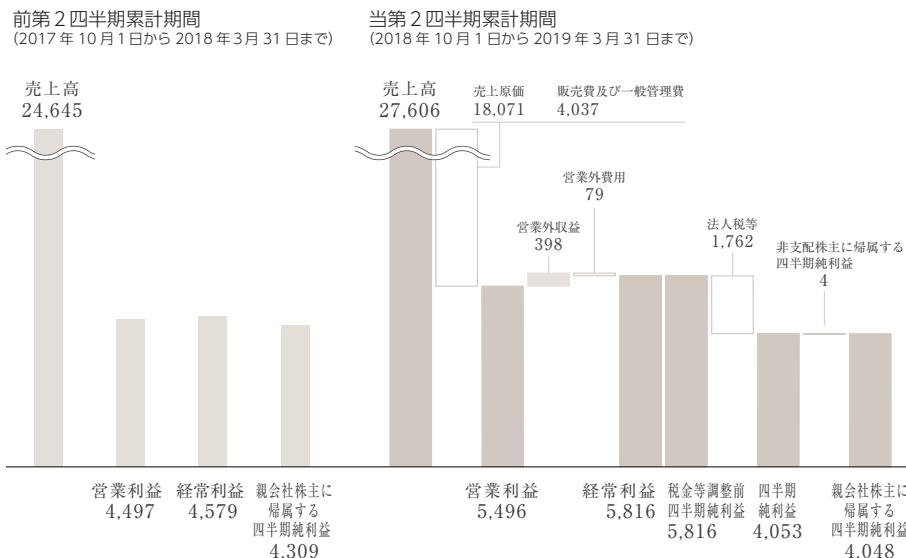
純資産

point
2

純資産は503億7百万円と、前期末に比べて22億19百万円増加しました。利益剰余金が28億72百万円増加したことなどによります。

損益の状況

(単位：百万円)



売上高・営業利益・ 経常利益・親会社株主に 帰属する四半期純利益

point
3

連結売上高276億6百万円(前年同期比12.0%増)、営業利益54億96百万円(前年同期比22.2%増)、経常利益58億16百万円(前年同期比27.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期に計上した一過性の特別利益が一巡したことなどにより、40億48百万円(前年同期比6.1%減)となりました。

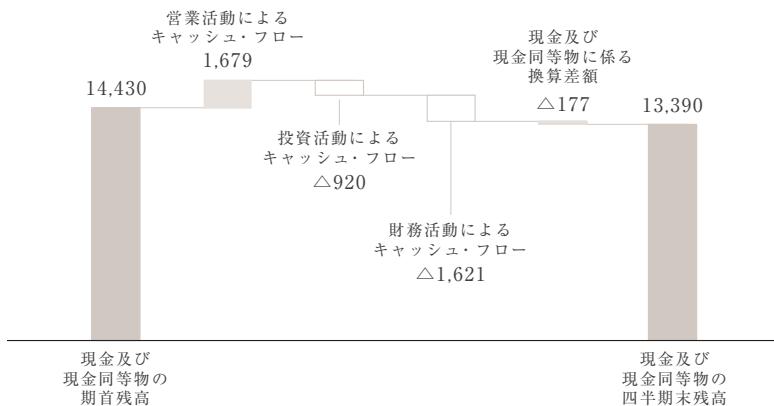
連結財務データ

キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間

(2018年10月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)



point
4

営業活動による キャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は16億79百万円となりました。税金等調整前四半期純利益が58億16百万円、減価償却費及びその他の償却費が4億93百万円となった一方、売上債権の増加額が20億6百万円、たな卸資産の増加額が5億55百万円、法人税等の支払額が19億1百万円発生したことなどによります。

point
5

投資活動による キャッシュ・フロー

投資活動により支出した資金は9億20百万円となりました。定期預金の純増加額が5億95百万円、有形固定資産の取得による支出が4億84百万円発生したことなどによります。

point
6

財務活動による キャッシュ・フロー

財務活動により支出した資金は16億21百万円となりました。短期借入金の純減少額が3億41百万円、配当金の支払額が12億64百万円発生したことなどによります。

会社情報

(2019年3月31日現在)

会社概要

商号	OBARA GROUP 株式会社
設立	1958年12月
資本金	19億25百万円
従業員数	単体：20名(連結1,786名)
本社所在地	神奈川県大和市中央林間 3-2-10 046-271-2111(代表)
主な事業	持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・ 推進、グループ経営の監査、その他経営管理
ウェブサイト	http://www.obara-g.com/

役員

取締役社長	小原 康嗣
取締役	小林 憲史
取締役	周澤 健
取締役	山下 光久
社外取締役	大西 倫雄*
社外取締役	牧野 宏司*
常勤監査役	谷内 博
社外監査役	須山 正志*
社外監査役	高橋 昌子*

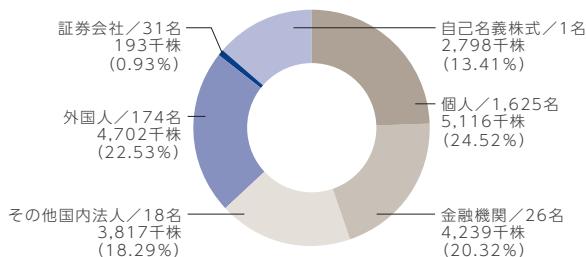
* 証券取引所が定める独立役員として届出を行っております。

株式情報 (2019年3月31日現在)

株式状況

発行可能株式総数	38,000,000株
発行済株式総数	20,869,380株
単元株式数	100株
株主数	1,875名

株主分布状況



大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
有限会社馬込興産	3,703	20.49
小原 康嗣	2,571	14.22
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	1,052	5.82
JP MORGAN CHASE BANK 385632	859	4.75
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	839	4.64
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578	639	3.53
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	638	3.53
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505253	393	2.17
GOVERNMENT OF NORWAY	379	2.10
株式会社三菱UFJ銀行	369	2.04

(注) 1. 上記のほか、自己株式2,798千株を保有しております。
 2. 持株比率は、自己株式2,798千株を控除して計算しております。
 3. 小原康嗣の持株数は自身の管理分株数1,084千株を加えて表示しております。

株主メモ

事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
定時株主総会	毎年12月
基準日	定時株主総会の議決権 毎年9月30日 期末配当 毎年9月30日 第2四半期末配当 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
特別口座の 口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱所 (郵便物送付先 お問い合わせ先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-782-031(フリーダイヤル)
同取次窓口	三井住友信託銀行株式会社 全国各本支店

公告方法

当社公告につきましては、下記ウェブサイトに掲載いたします。
<http://www.obara-g.com/>
 但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に公告を掲載いたします。

年間IRスケジュール

